

2025年度 第2四半期 決算説明資料

2025.10.29

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2025 2Q
売上高	104,622
売上総利益	72,748
GP率	69.5%
販売管理費	28,357
営業利益	44,391
経常利益	45,466
経常利益率	43.5%
税前利益	44,918
純利益	32,145

FY2025 1Q	QoQ	
	差額	(%)
売上高	14,708	16.4%
売上総利益	11,488	18.8%
GP率	1.4p	-
販売管理費	1,576	5.9%
営業利益	9,911	28.7%
経常利益	11,466	33.7%
経常利益率	5.7p	-
税前利益	11,266	33.5%
純利益	8,378	35.3%

FY2024 2Q	YoY	
	差額	(%)
売上高	8,379	8.7%
売上総利益	3,719	5.4%
GP率	-2.2p	-
販売管理費	1,903	7.2%
営業利益	1,816	4.3%
経常利益	4,037	9.7%
経常利益率	0.5p	-
税前利益	3,602	8.7%
純利益	2,416	8.1%

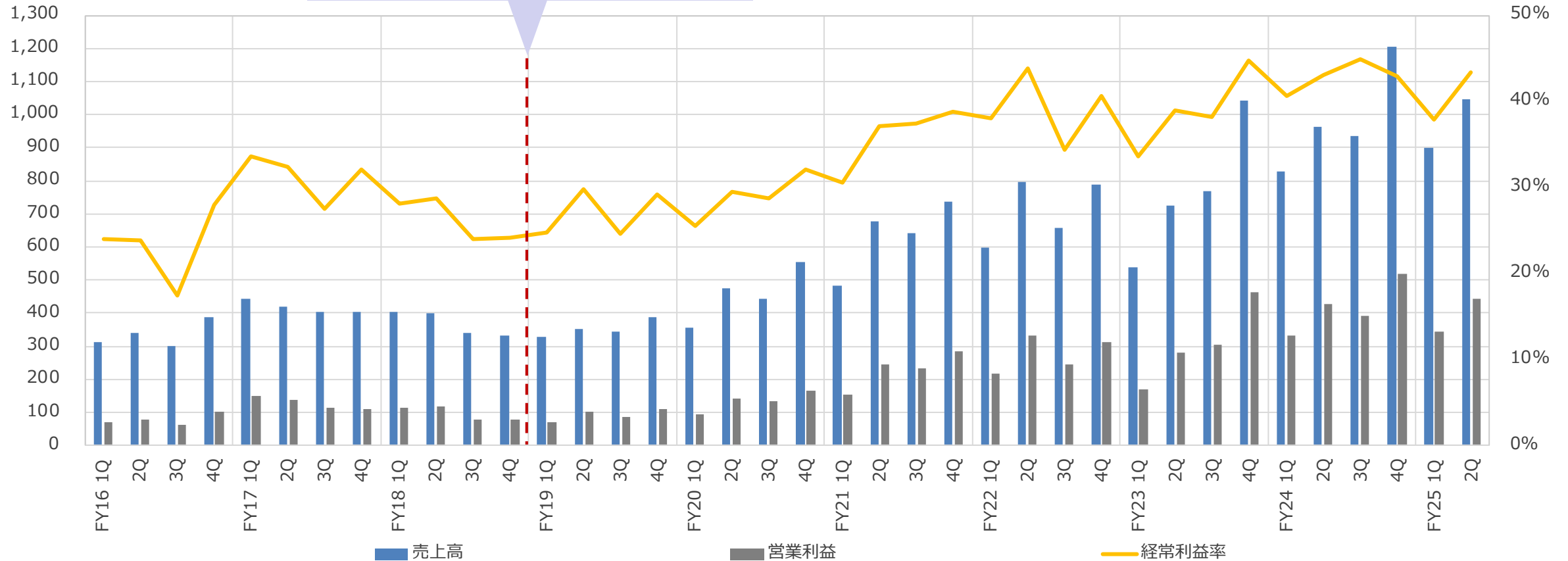
売上高： QoQ 機械装置の検収進捗および消耗品出荷堅調により増収
 GP率： QoQ 高付加価値製品の貢献により収益性上昇
 販売管理費： QoQ 人件費や研究開発費が増加

(単位：百万円)	FY2025 1H	FY2024 1H	YoY	
			差額	(%)
売上高	194,537	179,043	15,494	8.7%
売上総利益	134,009	126,728	7,281	5.7%
GP率	68.9%	70.8%	-1.9p	-
販売管理費	55,138	50,776	4,362	8.6%
営業利益	78,871	75,952	2,919	3.8%
経常利益	79,465	75,052	4,413	5.9%
経常利益率	40.8%	41.9%	-1.1p	-
税前利益	78,571	74,775	3,797	5.1%
純利益	55,913	53,443	2,470	4.6%

売上高： 生成AI向けを中心に出荷増・検収進捗により増収
 GP率： 製品構成および為替の影響により収益性はやや低下
 販売管理費： 人件費や研究開発費を中心に増加

(単位：億円)

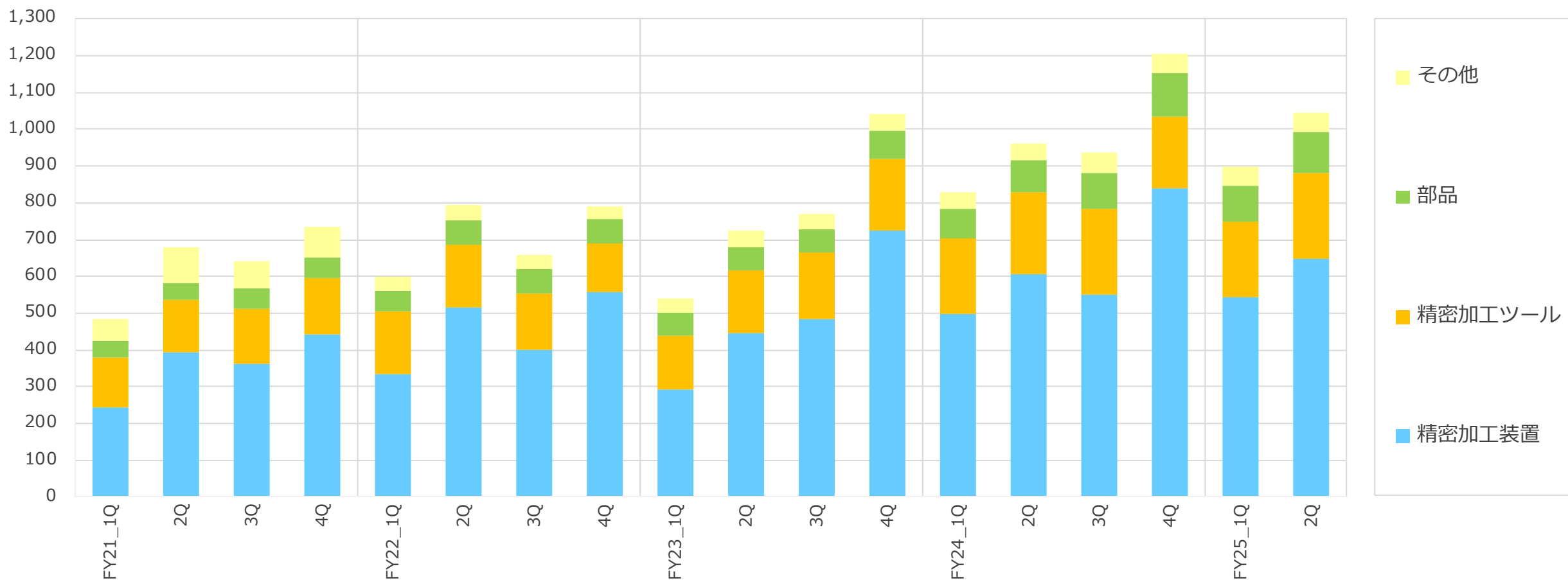
会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更



FY25_2Q 営業利益率42.4% 経常利益率43.5% 純利益率30.7%
※数値推移は、Webサイト「補足情報」に記載

製品群別売上高 四半期推移

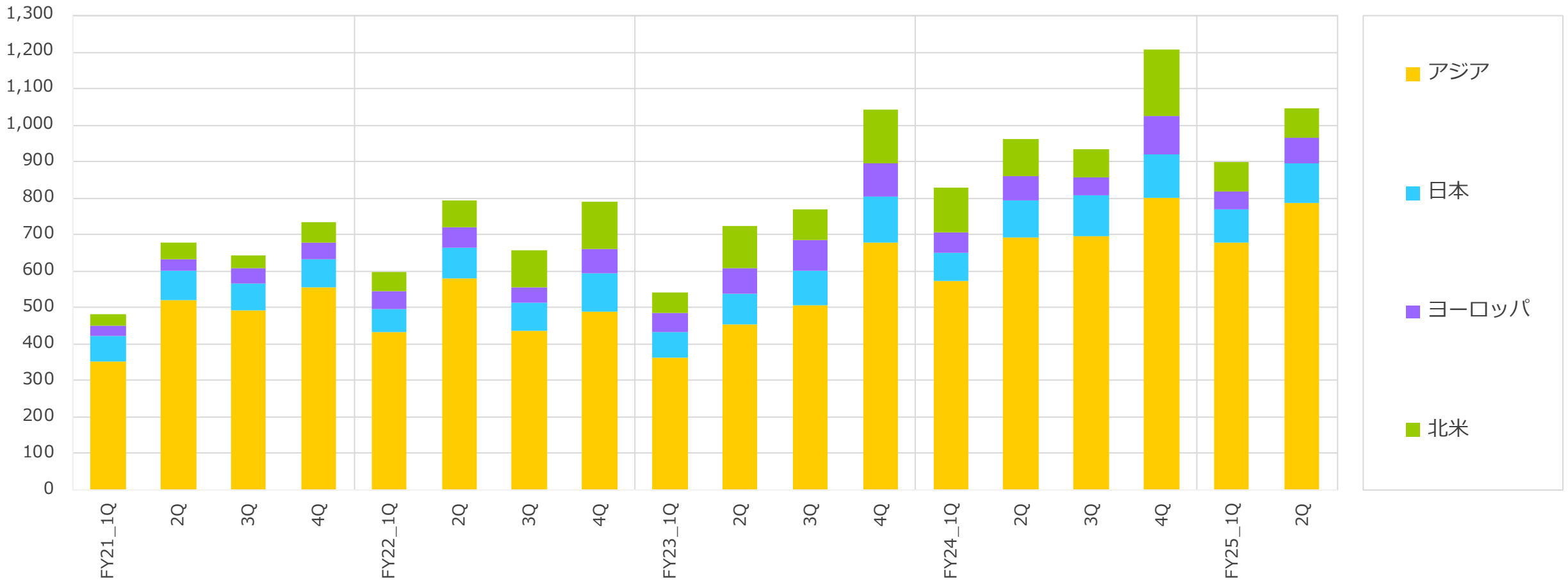
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

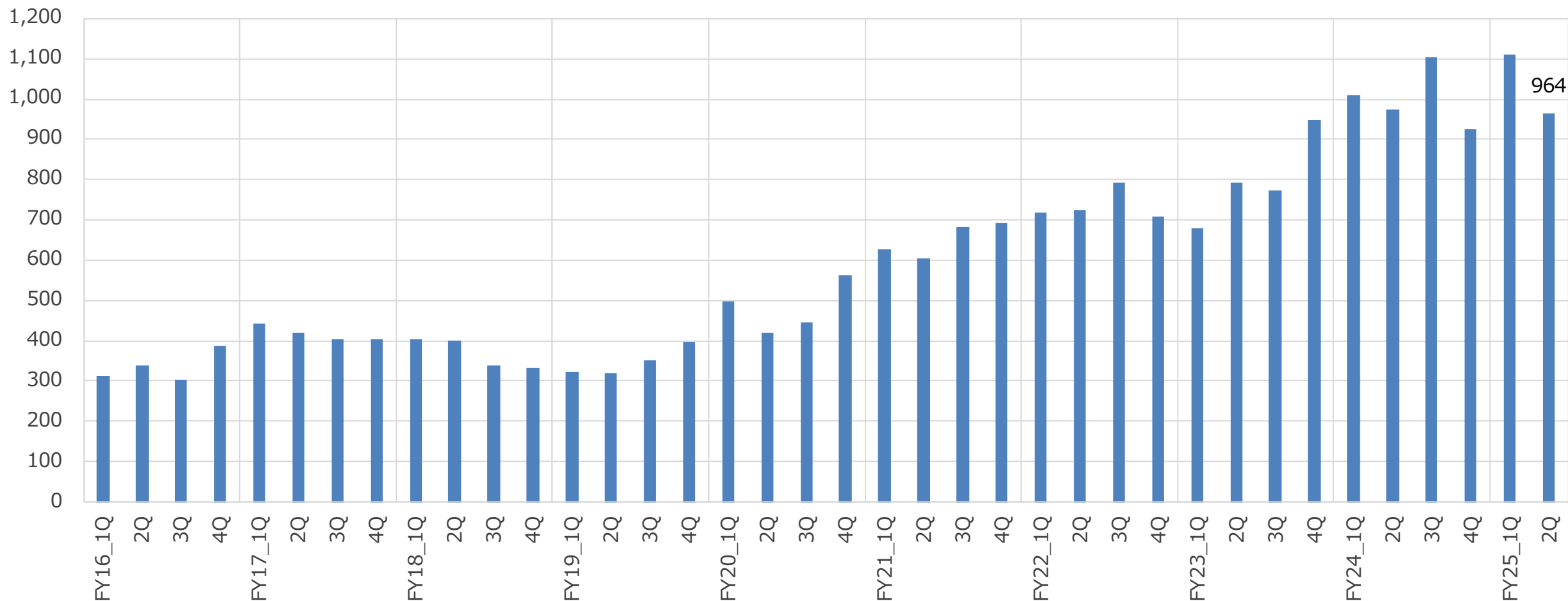
地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY25_2Q 海外売上高比率 89.9%

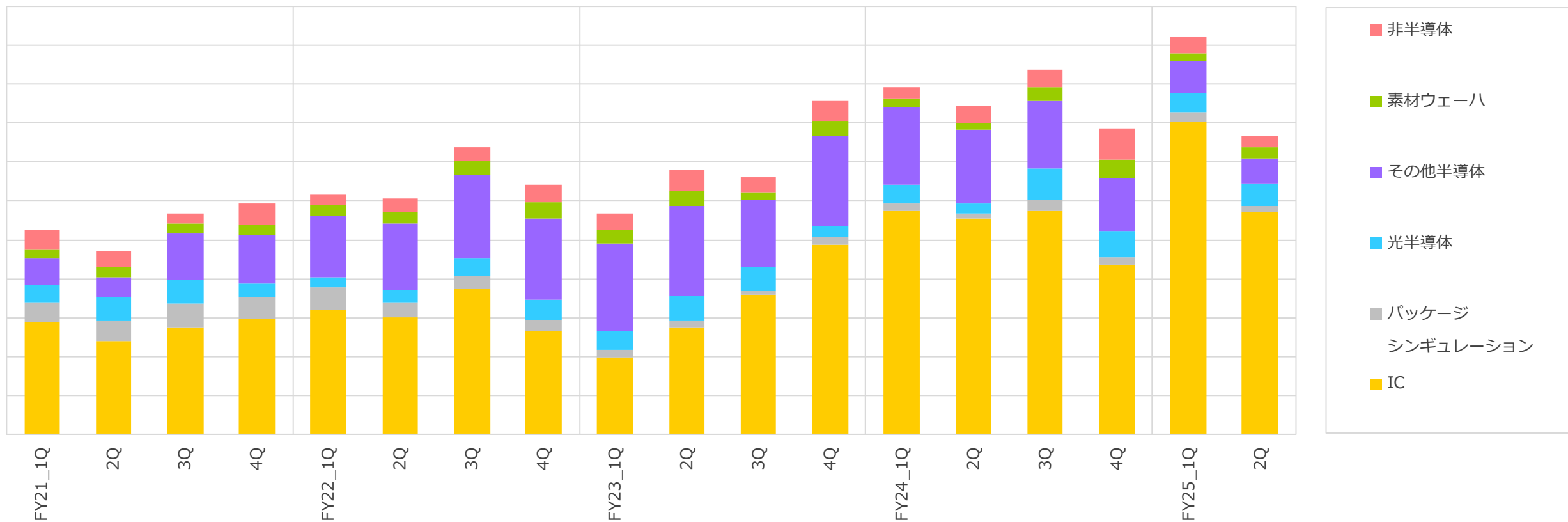
(単位：億円)



FY25_2Q 出荷額 約964億円

出荷額ベース

精密加工装置

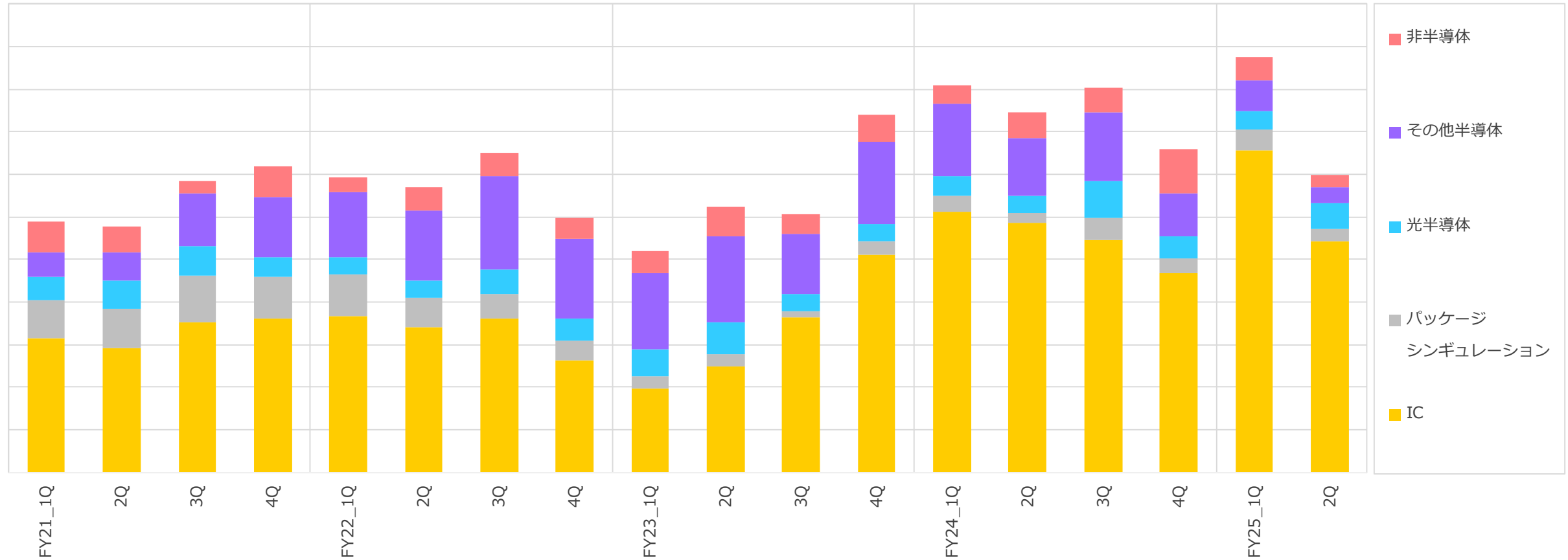


QoQ
YoY

IC向けは、前四半期に出荷が集中した反動により減少
主にパワー半導体（その他半導体）向けが減少

出荷額ベース

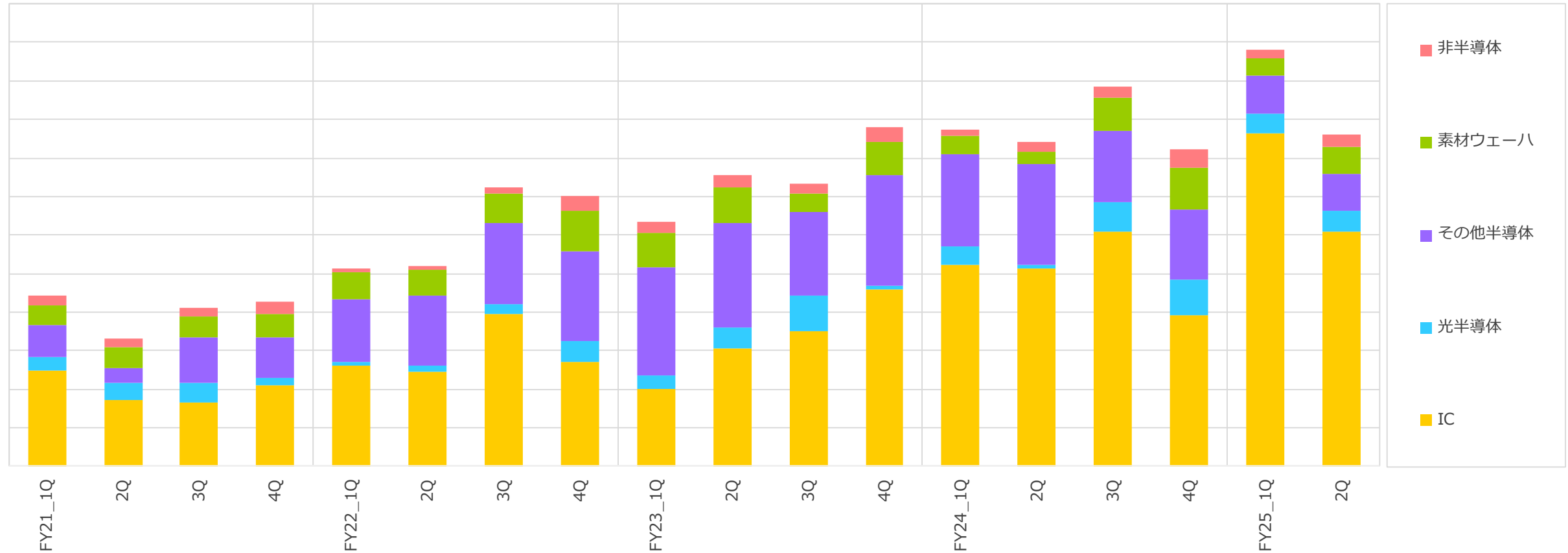
ダイサ



QoQ YoY IC向けは、前四半期に出荷が集中した反動により減少
ICおよびパワー半導体（その他半導体）向けが減少

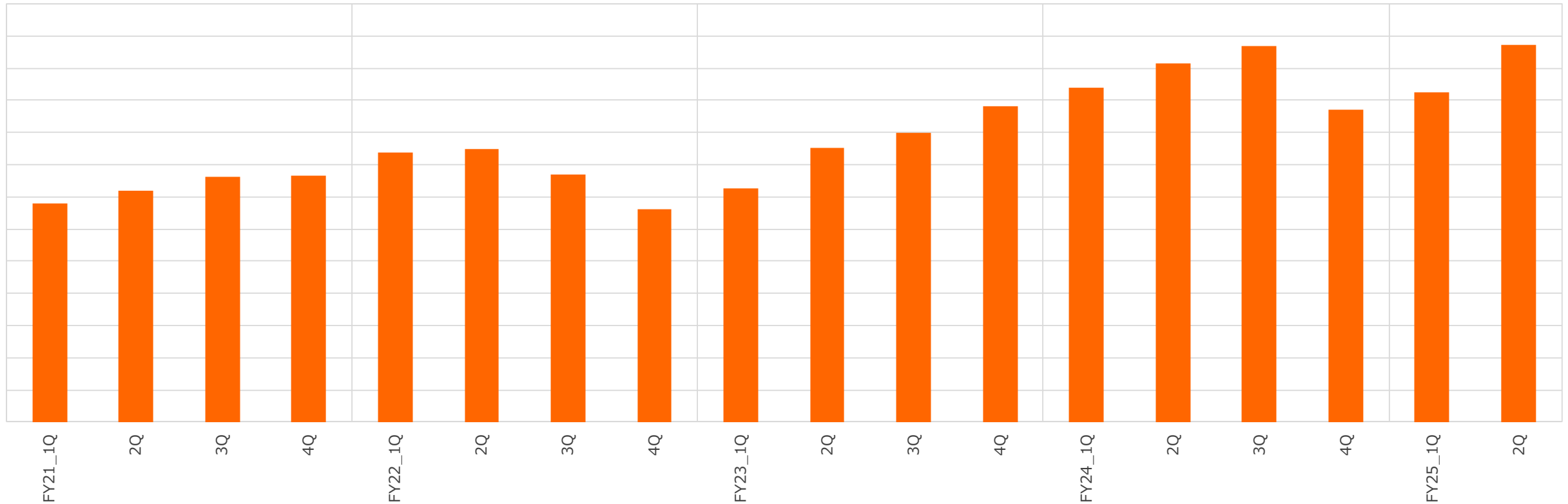
出荷額ベース

グラインダ



QoQ IC向けは、前四半期に出荷が集中した反動により減少

YoY パワー半導体（その他半導体）向けが減少した一方、IC向けは生成AI向けを中心に増加



顧客の設備稼働率等を背景に前四半期から増加し過去最高を更新

(単位：百万円)	FY2025 2Q	FY2025 1Q	差額
現金及び預金	222,909	198,498	24,411
受取手形・売掛金	53,785	47,952	5,834
棚卸資産	138,741	141,134	-2,393
流動資産	421,647	391,070	30,577
有形固定資産	210,997	206,601	4,396
固定資産	229,746	229,008	738
総資産	651,394	620,079	31,315
流動負債	132,726	134,120	-1,393
固定負債	960	1,040	-80
負債合計	133,687	135,160	-1,473
純資産	517,706	484,918	32,788
負債純資産合計	651,394	620,079	31,315
自己資本比率	79.2%	78.0%	1.2p

総資産：棚卸資産が減少した一方、現預金などが増加

負債：未払法人税等が増加した一方、賞与引当や仕入債務などが減少

純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：百万円)	FY2025 1H	FY2024 1H	差額
営業キャッシュ・フロー	39,683	60,948	-21,265
税前当期利益	78,571	74,775	3,797
減価償却	6,990	5,680	1,310
売上債権の増減	-9,402	5,105	-14,508
棚卸資産の増減	759	-16,721	17,480
仕入債務の増減	-8,138	-537	-7,601
法人税支払い	-31,310	-19,864	-11,446
その他営業CF	2,213	12,510	-10,297
投資キャッシュ・フロー	-15,274	-7,114	-8,161
有形固定資産の取得	-14,907	-7,121	-7,786
フリー・キャッシュ・フロー	24,408	53,834	-29,426
財務キャッシュ・フロー	-31,249	-24,934	-6,315
配当金支払い	-31,321	-24,996	-6,325
現金同等物増減	-6,257	28,084	-34,342
期首残高	229,167	215,486	13,681
期末残高	222,909	243,571	-20,661

- 営業C F・・・約396億円 資金増加
主に税前利益による資金増加
 - 投資C F・・・約152億円 資金減少
主に有形固定資産の取得によるもの
 - フリー・キャッシュ・フロー
約244億円の資金増加
 - 財務C F・・・約312億円 資金減少
主に配当金の支払い
- 9月末の現金残高 約2,229億円

(単位：億円)

今回予想

	FY24 1Q	2Q	3Q	4Q	FY25 1Q	2Q	3Q
売上高	828	962	936	1,207	899	1,046	926
営業利益	334	426	391	517	345	444	328
経常利益	336	414	420	519	340	455	329
純利益	237	297	318	386	238	321	244
営業利益率	40.3%	44.2%	41.8%	42.9%	38.3%	42.4%	35.4%
経常利益率	40.6%	43.0%	44.9%	43.0%	37.8%	43.5%	35.5%
純利益率	28.6%	30.9%	34.0%	32.0%	26.4%	30.7%	26.3%
出荷額	1,011	976	1,103	925	1,111	964	1,016

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 3Q (10-12月期)
為替感応度 (年換算)

US\$: 145円
US\$: 約16億円

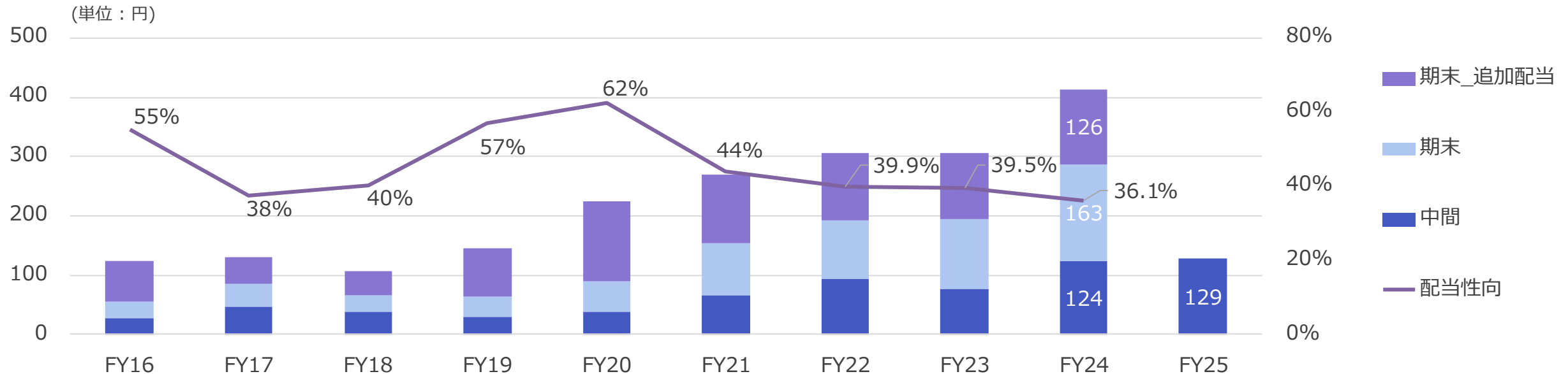
Euro : 172円
Euro : 約1億円

ご参考 前四半期と同一為替レートで換算した場合の10-12月期予想
出荷額：1,032億円 売上高：940億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY25 中間（実績）129円 期末：未定

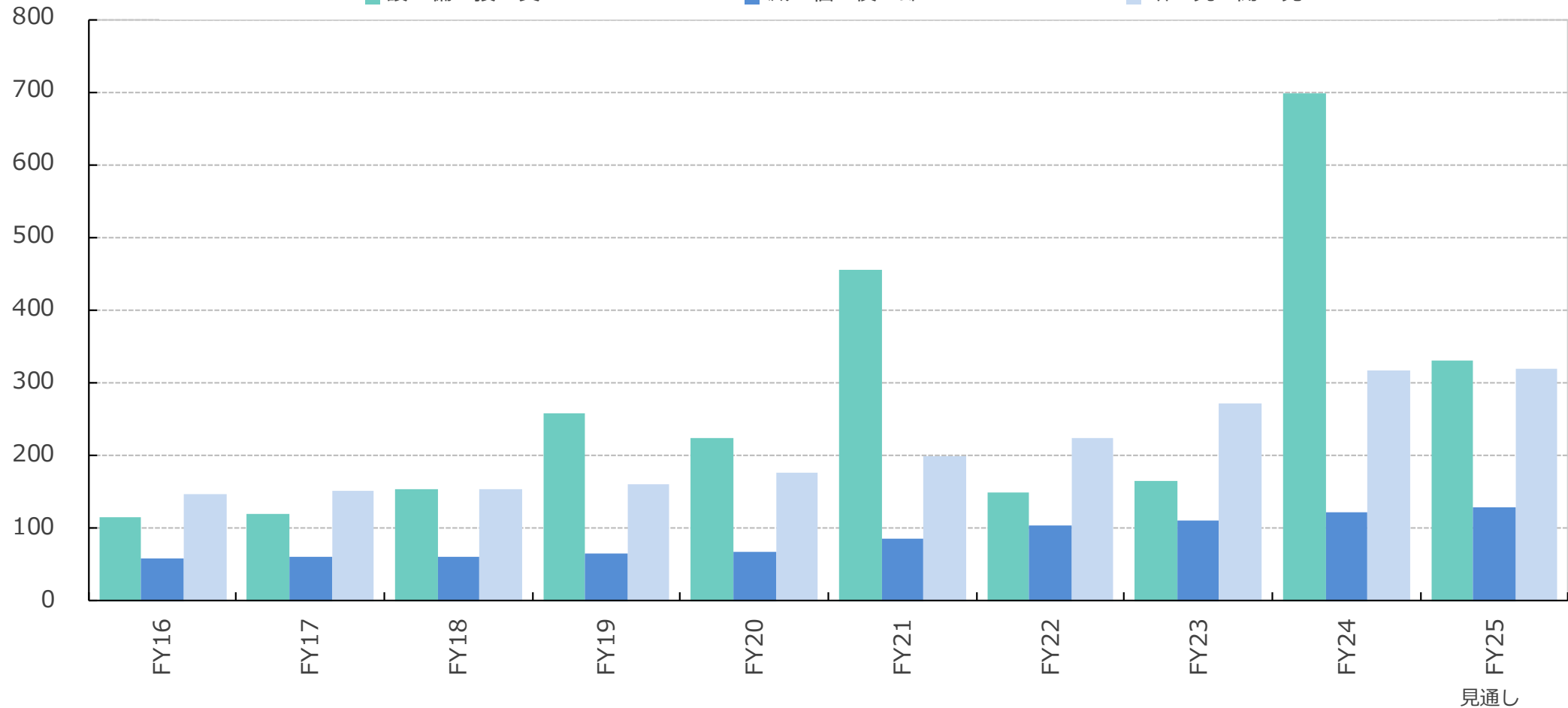
※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
（FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載）

(単位：億円)

■ 設備投資

■ 減価償却

■ 研究開発



FY25見通し

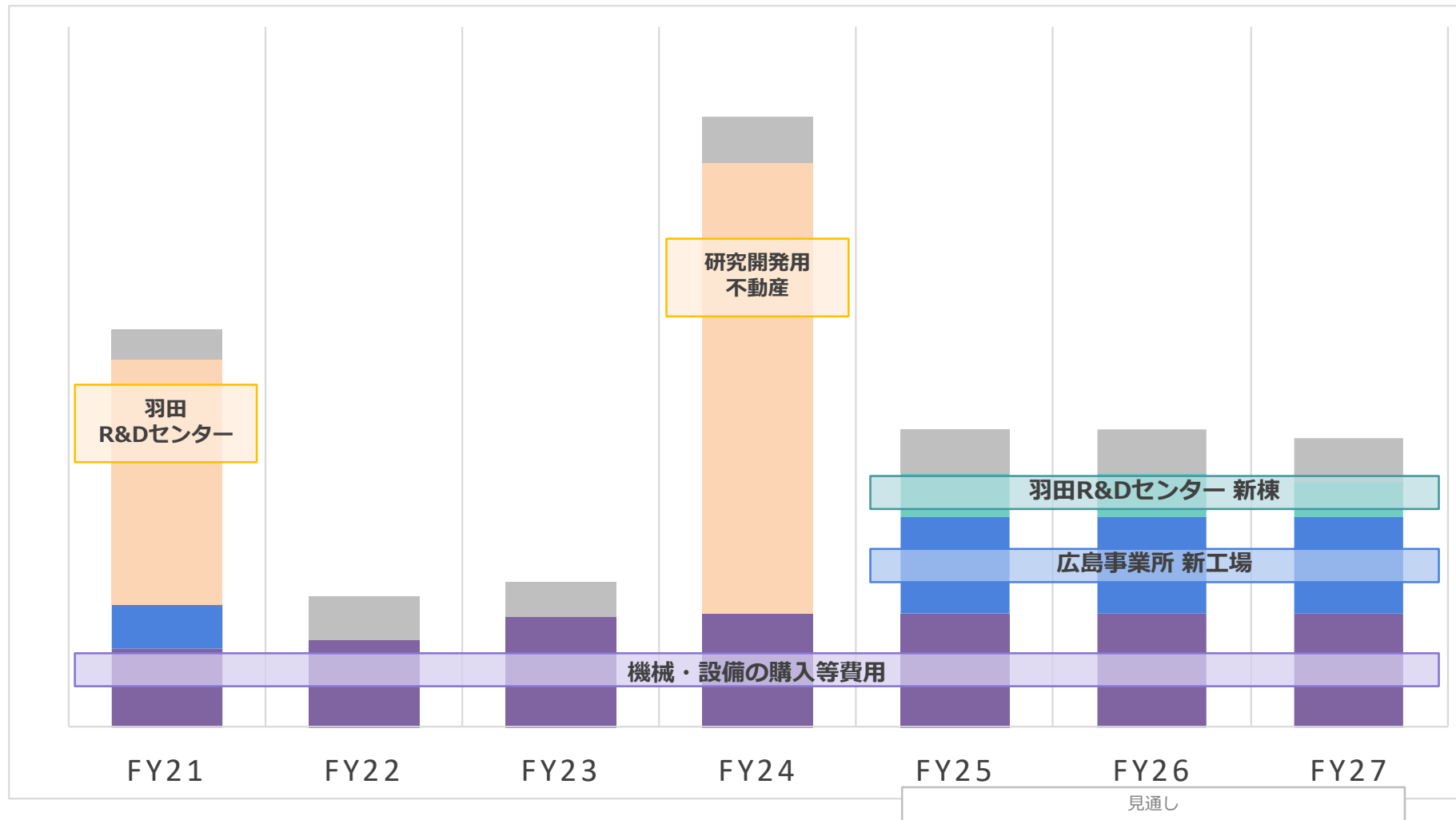
設備投資：約330億円

減価償却：約140億円

研究開発：約330億円

合理化投資、羽田R&Dセンター建替、新工場建築を含む

積極的な研究開発活動を継続



研究開発用不動産
羽田R&Dセンター 新棟
広島事業所 新工場

約500億円
約140億円
約330億円

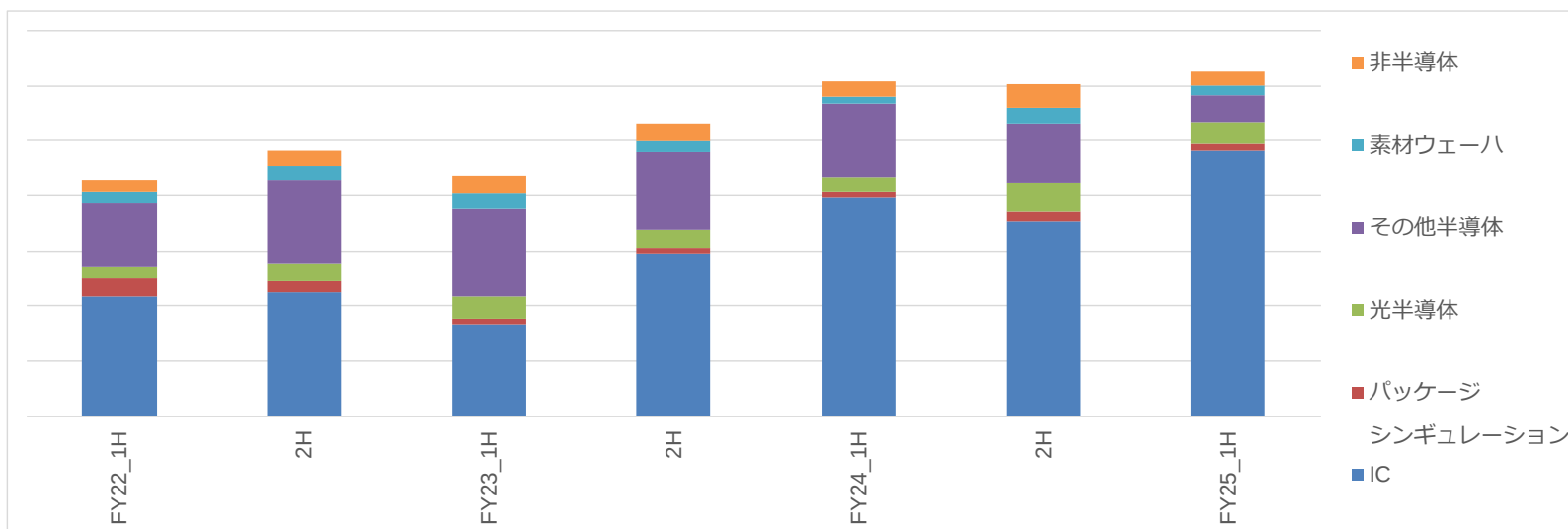
支出時期：FY24
支出時期：FY25～FY27
支出時期：FY25～FY27

出荷額ベース

製品群			見通し FY25_3Q 増減率（QoQ）
		ブレードダイサ	-20%
		レーザソー	25%
	ダイサ		0%
	グラインダ		25%
	周辺装置		40%
精密加工装置			15%
精密加工ツール			0%
その他			-20%

■ 出荷動向：半期ベースで過去最高を更新

P C・スマホ・自動車関連の需要が力強さを欠く一方、生成 A I 関連の需要拡大を背景に、メモリ・ロジック向けの装置出荷は高水準で推移

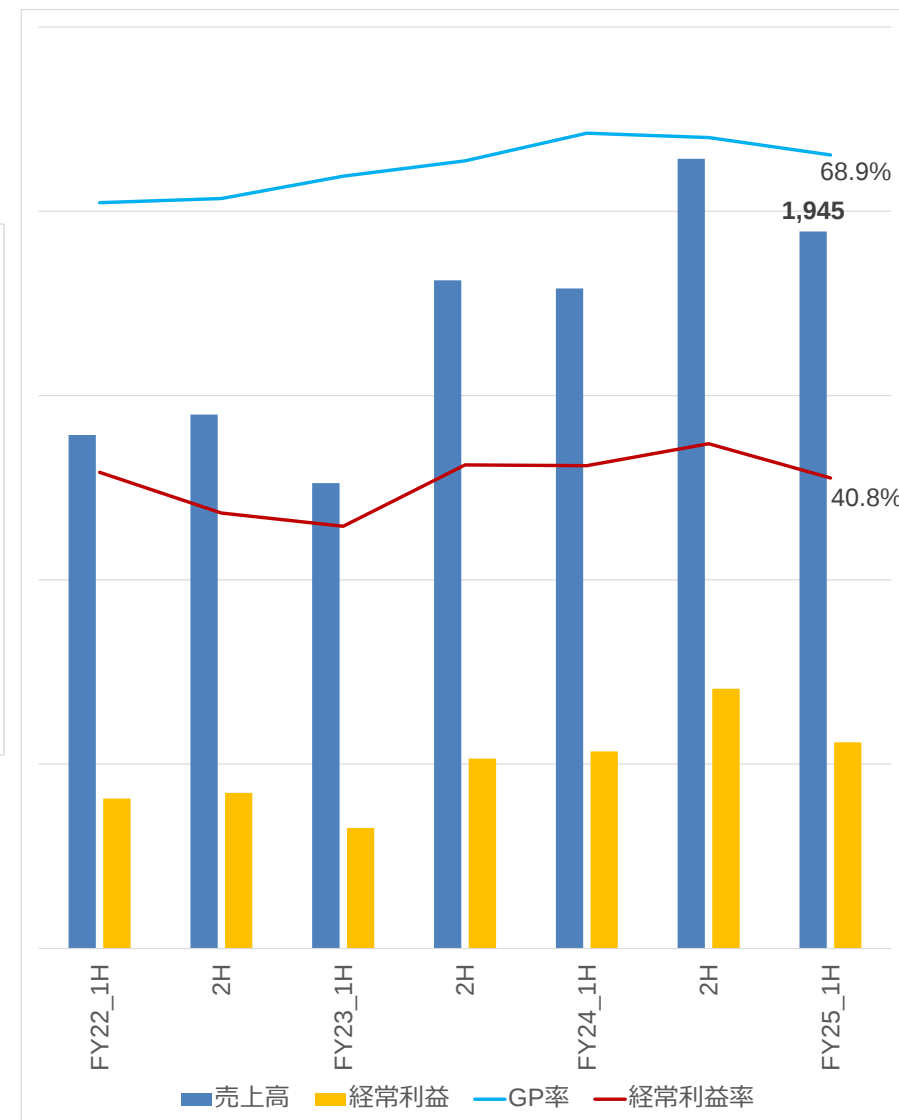


■ 業績では引き続き高付加価値製品が貢献

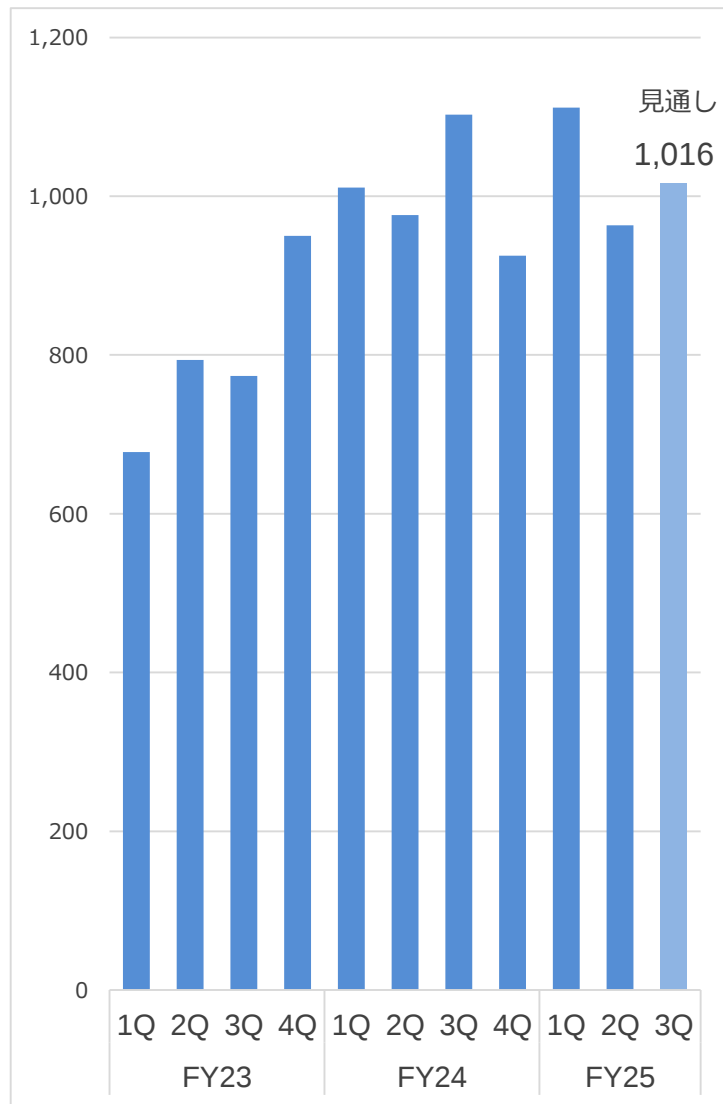
G P 率が為替影響・高水準からの反動で若干低下も、経常利益率は引き続き40%台の高水準で推移

■ 中間配当は業績連動により増配 今回129円（前年124円）

業績推移（検収基準） 単位：億円



出荷額 四半期推移（億円）



- **生成A I 向け装置出荷は最終需要等に連動して継続**
- **先端パッケージ技術は用途拡大および本格立ち上がり期待**
- **事業環境の変化に対応**
半導体メーカーの投資動向に対応しつつ、国際情勢を踏まえたサプライチェーン・調達体制の変化やリスクを注視
- **ファブリケーションは競争力の源泉**
Fab Important戦略のもと、開発と製造の一体化による競争力強化のため、自社拠点への積極的な設備投資を継続
(羽田R&Dセンター新棟、広島事業所郷原工場、他)
- **良質な企業文化は会社を強くする源泉**
DISCO VALUES、Will会計、PIM活動など、「会社を強くする」取り組みに引き続き注力

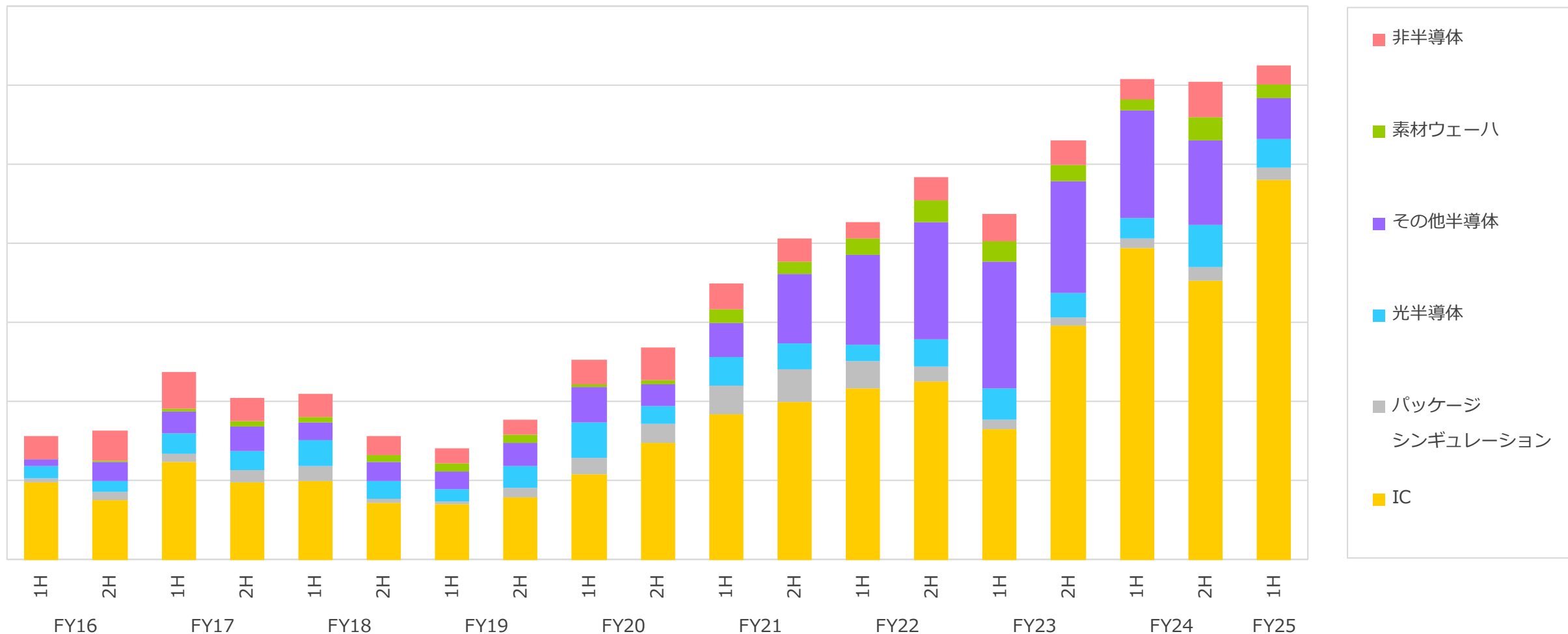
ご参考 半期・通期推移 グラフ集

精密加工装置 用途別売上高

出荷額ベース

半期

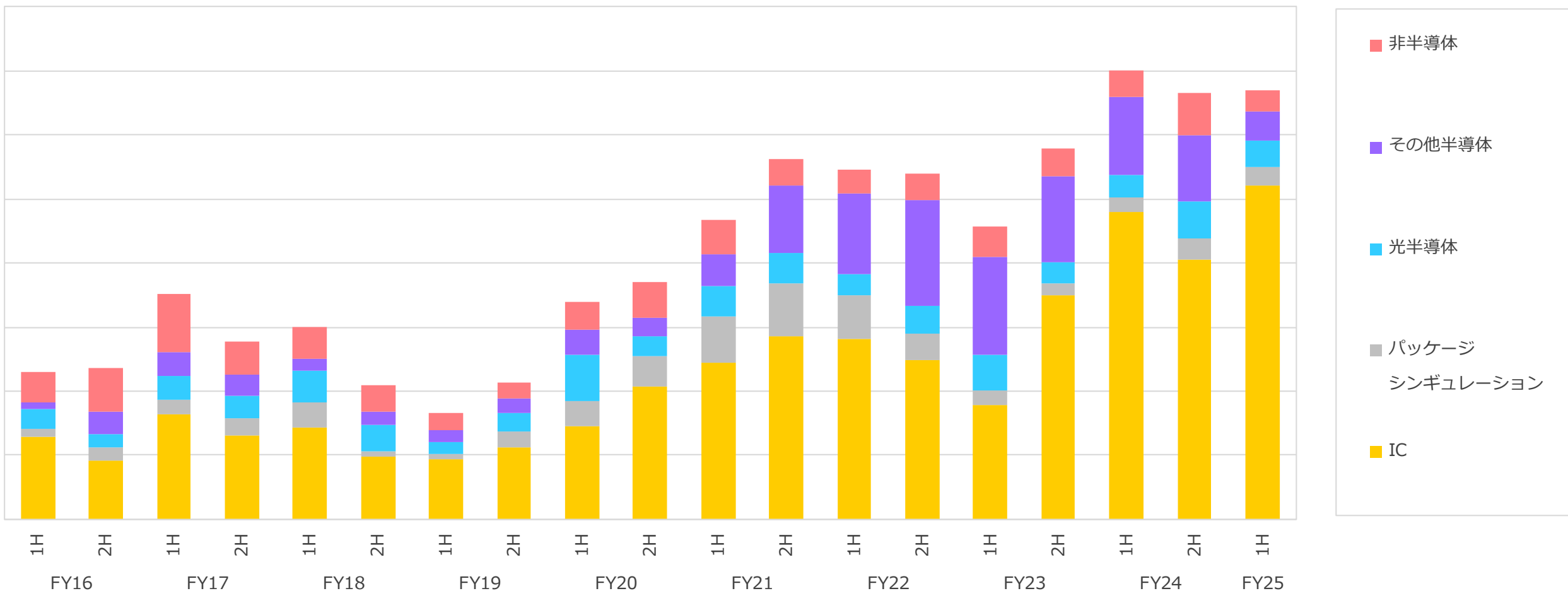
精密加工装置



出荷額ベース

半期

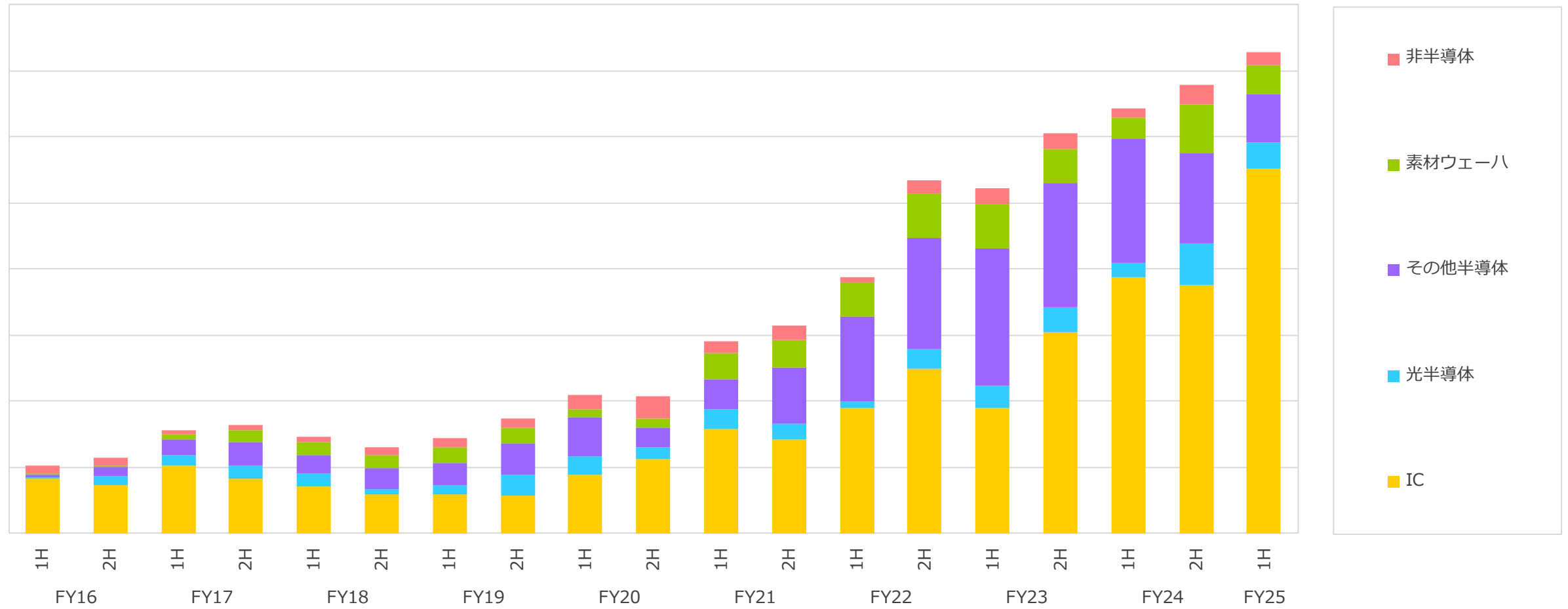
ダイサ



出荷額ベース

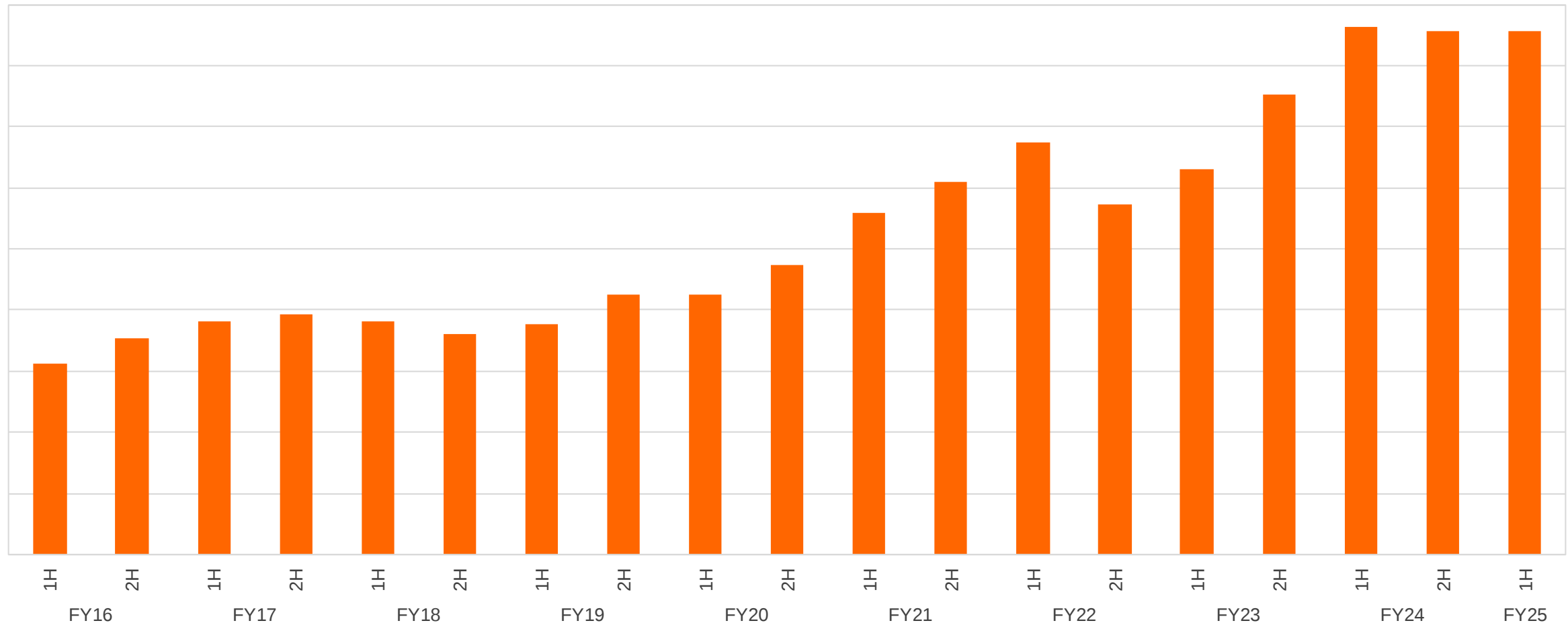
半期

グラインダ



出荷額ベース

半期



【ご参考】製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	2Q			1H	
	構成比	QoQ	YoY	構成比	YoY
精密加工装置合計	58%	-25%	-11%	63%	2%
内、ダイサ	29%	-29%	-17%	32%	-5%
ブレードダイサ	17%	-18%	6%	17%	5%
レーザソー	12%	-39%	-36%	15%	-14%
内、グラインダ	27%	-20%	2%	28%	13%
内、周辺装置	3%	-37%	-40%	3%	-19%
精密加工ツール	24%	13%	1%	21%	0%
その他	18%	11%	46%	16%	26%
出荷額合計	100%	-13%	-1%	100%	4%

出荷額ベース

		FY24				FY25	
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q
ダイサ	1_IC	67%	69%	60%	62%	78%	78%
	2_パッケージ・シンギュレーション	4%	3%	6%	4%	5%	4%
	3_光半導体	5%	5%	10%	7%	5%	9%
	4_その他_半導体	19%	16%	18%	13%	7%	5%
	5_非半導体	5%	7%	7%	14%	6%	4%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	60%	61%	62%	48%	80%	71%
	2_光半導体	6%	1%	8%	11%	5%	6%
	3_その他_半導体	27%	31%	19%	22%	9%	11%
	4_素材ウエーハ	6%	4%	9%	14%	4%	8%
	5_非半導体	2%	3%	3%	6%	2%	4%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY24				FY25	
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q
ダイサ	1_IC	210%	135%	50%	-8%	23%	-7%
	2_パッケージ・シンギュレーション	23%	-15%	270%	7%	33%	14%
	3_光半導体	-26%	-46%	112%	26%	-5%	50%
	4_その他_半導体	-3%	-33%	15%	-48%	-58%	-72%
	5_非半導体	-17%	-13%	26%	65%	34%	-54%
ダイサ		75%	36%	49%	-10%	7%	-17%
グライнда	1_IC	160%	68%	73%	-14%	66%	18%
	2_光半導体	46%	-86%	-15%	819%	-1%	652%
	3_その他_半導体	-16%	-4%	-15%	-37%	-59%	-63%
	4_素材ウエーハ	-45%	-62%	79%	26%	-8%	104%
	5_非半導体	-50%	-24%	19%	31%	46%	29%
グライнда		37%	11%	34%	-6%	24%	2%

出荷額ベース

		FY24				FY25	
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q
ダイサ	1_IC	20%	-4%	-7%	-14%	62%	-28%
	2_パッケージ・シンギュレーション	14%	-34%	119%	-35%	43%	-44%
	3_光半導体	10%	-12%	115%	-40%	-16%	40%
	4_その他_半導体	-11%	-22%	19%	-37%	-28%	-48%
	5_非半導体	-34%	46%	-3%	77%	-47%	-50%
ダイサ		8%	-7%	7%	-16%	29%	-29%
グラインダ	1_IC	14%	-2%	18%	-35%	120%	-30%
	2_光半導体	402%	-85%	952%	20%	-46%	10%
	3_その他_半導体	-17%	10%	-29%	-3%	-46%	-1%
	4_素材ウエーハ	-45%	-29%	148%	29%	-59%	56%
	5_非半導体	-59%	62%	24%	61%	-55%	44%
グラインダ		-1%	-4%	17%	-16%	31%	-20%

検収ベース

■ 構成比	FY2024				FY2025	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
日本	9%	11%	12%	10%	10%	10%
アメリカ	15%	10%	8%	15%	9%	8%
アジア	69%	72%	74%	66%	75%	75%
シンガポール	6%	8%	8%	7%	7%	7%
台湾	16%	17%	19%	22%	27%	28%
韓国	14%	12%	9%	9%	9%	10%
中国 ※	32%	33%	37%	27%	30%	28%
その他	1%	1%	1%	2%	3%	2%
ヨーロッパ	7%	7%	5%	9%	6%	7%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

**当社ではMissionの実現性の向上に取り組むことで、
結果として企業価値の向上と競争力向上に繋がり、
資本市場の皆さまの期待に応えることができると考えています**

- ✓ 事業の質の追求
- ✓ 自己資金の活用と目的
- ✓ 株主還元方針
- ✓ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

上記の考え方について[詳しくはこちら](#)をご確認ください

本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。

金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。

%は実際の金額を基に算出しています。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

英語圏の方々のために英語資料を提供する場合、和文（原文）と英訳の内容が相違した際は和文の内容が優先されます。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>